

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于申请 2024 年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过《关于申请 2024 年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、相关情况概述

为满足公司及全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称“无锡伟测”）及南京伟测半导体科技有限公司（以下简称“南京伟测”）日常生产经营及相关项目建设、投资等相关资金需求，便于公司及子公司各项业务正常开展，公司及子公司 2024 年拟向合作银行申请总额不超过人民币 11.90 亿元银行授信额度，用于公司及子公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理中短期流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池质押融资业务、国内外信用证、国际贸易融资、国内买方保理、外汇衍生交易信用额度、国内保函、商票保贴、供应链融资等业务。具体明细如下：

单位：万元

序号	授信方	授信金额	授信期限	额度使用单位
1	交通银行股份有限公司上海张江支行	20,000.00	1 年	公司
2	中信银行股份有限公司上海分行	15,000.00	1 年	公司
3	中国民生银行股份有限公司上海分行	10,000.00	1 年	公司

4	招商银行股份有限公司上海分行	10,000.00	1 年	公司
5	中国建设银行股份有限公司上海张江分行	10,000.00	1 年	公司
6	中国农业银行股份有限公司上海川沙支行	5,000.00	1 年	公司
7	招商银行股份有限公司无锡分行新区支行	5,000.00	1 年	无锡伟测
8	中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行	2,000.00	1 年	无锡伟测
9	中信银行股份有限公司无锡新区支行	10,000.00	1 年	无锡伟测
10	花旗银行（中国）有限公司上海分行	10,000.00	1 年	无锡伟测
11	招商银行股份有限公司南京分行	10,000.00	1 年	南京伟测
12	中国农业银行股份有限公司	10,000.00	1 年	南京伟测
13	中信银行南京分行中山东路支行	2,000.00	1 年	南京伟测
合计		119,000.00		

具体融资金额在综合授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求情况确定。授信期限以签署的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。

为解决向上述银行申请综合授信额度所需担保事宜，公司拟使用自有（含全资子公司）的土地使用权、房产、机器设备、存货、票据、相关保证金账户及账户内资金、存单、结构性存款等资产提供抵押或质押担保，合计最高抵押或质押金额预计不超过 5,000 万元。公司将结合资金需求情况分批次向银行申请，具体融资额度、担保措施等相关内容均以公司与银行所签订合同约定为准。实际抵押的资产以和金融机构签订的合约为准。

签订上述授信额度相关协议的有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。为提高融资效率，董事会提请股东大会授权公司董事长骈文胜先生或其授权代表在上述授信额度范围内审核并签署相关融资、抵押或质押担保合同文件。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日